

Judul:

Proses Elektrodeposisi Tembaga Dalam Deep Eutectic Solvents Dari Limbah Printed Circuit Board (PCB) = Copper Electrodeposition Process In Deep Eutectic Solvents From Printed Circuit Board (PCB) Waste

Pengarang/Penulis:

Heryatna, author

Subjek:

Electrodes, Copper; Solvents

Nomor Panggil:

T-pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)